



Baumit Baumacol Basic

Zaprawa klejowa do płytek, klasa C1T

Korzyści

- pozwala kleić płytki od góry
- grubość warstwy 2-10 mm
- wodo- i mrozoodporna



Produkt

Zaprawa klejowa na bazie szarego cementu. do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Posiada certyfikat EMICODE EC 1 PLUS.

Właściwości

Wodo- i mrozoodporna, tiksotropowa, hydraulicznie wiążąca, cienkowarstwowa zaprawa klejowa. Dopuszczona do kontaktu ze środkami spożywczymi.

Przeznaczenie

Do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych. Do stosowania na podłożach nieodkształcalnych, na wszelkie powierzchnie mineralne o zwykłych wymaganiach, wewnątrz i na zewnątrz budynków, w pomieszczeniach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej.

Dane techniczne

Produkt	
Klasyfikacja:	C1 T wg PN-EN 12004:2002
Czas korekty:	do 5 min.
Min. grubość warstwy:	2 mm
Max. grubość warstwy:	10 mm
Czas otwarty:	do 20 min.
Czas dojrzewania:	ok. 15 min.
Czas obróbki:	do 4 godz.

Wariant(y)	Baumit Basic 25 kg
Zużycie	ok. 3 kg/m ² /2mm
Zapotrzebowanie wody	ok. 6 l/25kg

Paca zębata:	3 mm	6 mm	10 mm
Zużycie około:	1,5 kg/m ²	2,5 kg/m ²	3,5 kg/m ²



Opakowanie

Worek 25 kg, 42 wor./pal. = 1050 kg

Przechowywanie

W suchym i chłodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

Gwarancja jakości	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.
Bezpieczeństwo	Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie www.baumit.pl
Podłoże	Podłoże musi być czyste, suche, nieprzemarznięte, odpylone i odtłuszczone, wolne od wykwitów, nośne i pozbawione luźnych cząstek. Zaprawę można stosować na: beton, jastrych, gazobeton, klinkier, gotowe tynki cementowe i gipsowe, kartonowe płyty gipsowe, gipsowe ściennie płyty budowlane, jastrychy anhydrytowe (odpowiednio zagruntowane). Nie stosować na: drewno, metal, tworzywa sztuczne, podłoża na bazie cementu przed zakończeniem procesów wiązania oraz w obrębie tarasów, elewacji, basenów kąpielowych i ogrzewania podłogowego.
Przygotowanie podłoża	Podłoże oczyścić z pyłu, kurzu oraz zagruntować odpowiednim preparatem : w przypadku podłoży chłonnych - Baumit Grund, w przypadku podłoży niechłonnych - Baumit SuperPrimer.
Obróbka	<p>Zalecane narzędzia: Wolnoobrotowe mieszadło elektryczne, paca zębata, kielnia, gąbka paca 3 x 3 mm - klejenie mozaiki paca 6 x 6 mm - klejenie płytek o spodzie gładkim 10 x 10 mm - klejenie płytek o spodzie profilowanym</p> <p>Wyspać zawartość worka do odpowiedniej ilości czystej wody i mieszać przez ok. 3 min. czystym, wolnoobrotowym mieszadłem do uzyskania jednorodnej masy. Po ok. 15 min. ponownie, krótko przemieszać zaprawę.</p> <p>Używając odpowiedniej pacy zębatej, nanosić zaprawę klejową równomiernie na podłoże (pacę utrzymywać podczas rozprowadzania materiału pod kątem 45 stopni do podłoża). Kleić wyłącznie świeżą zaprawą, ewentualne jej pozostałości usuwać zwilżoną gąbką.</p> <p>Zalecane pokrycie spodu płytki klejem (wypełnienie przestrzeni podpłytkowej):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ wewnątrz budynków > 65% ■ na zewnątrz budynków > 90% <p>Zapewnienie pełnego kontaktu płytki z klejem można otrzymać poprzez układanie płytek metodą kombinowaną (BUTTERING - FLOATING), polegającą na nanoszeniu zaprawy klejowej zarówno na podłoże jak i na spód płytki.</p> <p>Przez ok. 48 godzin chronić klejoną powierzchnię przed obciążeniami mechanicznymi i termicznymi (nie chodzić i nie obciążać ułożonych płytek).</p>
Wskazówki	<p>Przestrzegać norm, wytycznych i innych informacji technicznych dotyczących podłoża i okładzin.</p> <p>Nie stosować w temperaturze poniżej + 5°C lub powyżej +25°C, w deszczu, przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze lub przeciągach. Chronić do czasu pełnego utwardzenia.</p> <p>Wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury wydłużają przewidziany czas schnięcia, wysokie temperatury skracają czas wiązania i utwardzania!</p> <p>Nie dodawać żadnych innych materiałów!</p> <p>Nie moczyc ani podłoża ani płytek.</p> <p>Bezwzględnie przestrzegać podanego czasu otwartego - schnięcia naniesionej na podłoże zaprawy klejowej. Po przekroczeniu tego czasu zaprawę należy usunąć.</p>

Produkt przeznaczony jest do stosowania zgodnie z jego aktualną kartą techniczną, instrukcją producenta oraz zasadami sztuki budowlanej. Przed użyciem należy zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz zweryfikować przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Na właściwości użytkowe i parametry końcowe istotny wpływ mają w szczególności: sposób przechowywania, proporcje dozowania wody (jeżeli dotyczy), czas i sposób mieszania, warunki aplikacji (temperatura, wilgotność, opady itd.), rodzaj i przygotowanie podłoża oraz warunki wiązania i wysychania. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta oraz wykonania próby przed rozpoczęciem prac na większej powierzchni. Parametry techniczne podane w dokumentacji oparte są na badaniach laboratoryjnych i mogą ulec zmianie w warunkach rzeczywistych. Faktyczne zużycie materiału zależy od chłonności i równości podłoża, sposobu prowadzenia prac i doświadczenia wykonawcy oraz technologii aplikacji. Produkt powinien być przechowywany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, nie narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w warunkach suchych i w sposób zgodny z zaleceniami producenta. Użycie materiału zawilgoconego, przeterminowanego lub przecho-wywanego niezgodnie z zaleceniami odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z rozwoju technologii lub ulepszania wyrobu. Aktualna dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie internetowej producenta. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje.